

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

이오테크닉스 (039030)

반도체향 매출 비중 증가는 현재형

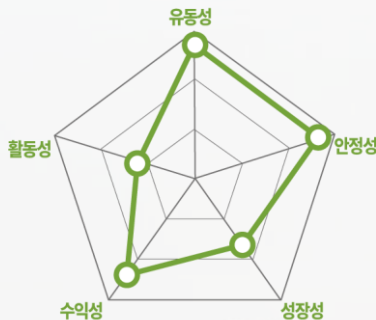
체크포인트

- DRAM 미세화와 HBM 및 NAND의 Hybrid Bonding 적용으로 레이저 어닐링의 적용 공정 확대와 고객 다변화 기대. 신규 장비인 레이저 디본더는 생산성과 가격 경쟁력을 바탕으로 Foundry와 OSAT으로 공급 중
- 피코세컨드 그루빙 장비는 OSAT와 HBM향으로 공급되어 전년 대비 매출액 2배 성장 기대. 고객사의 도입 속도에 따라 실적 업사이드도 있다고 판단
- 2025년 동사의 실적은 매출액 3,796억 원(+18.3% YoY), 영업이익 653억 원(+109.4% YoY)을 전망. 매출액 확대와 수익성이 상대적으로 높은 반도체 장비 매출 비중 증가로 전년 대비 크게 개선된 영업이익률 17.2%(+7.5%p YoY)를 예상

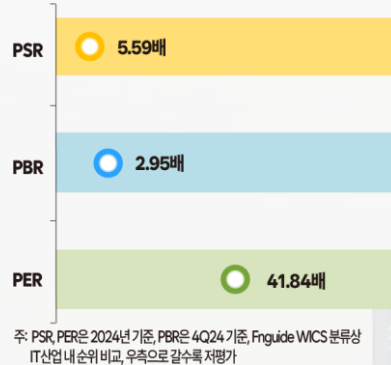
주가 및 주요이벤트



재무지표



밸류에이션 지표



이오테크닉스 (039030)

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr

RA 김혜빈 hbkim@kirs.or.kr

KOSDAQ

반도체와반도체장비

레이저 장비 업체

이오테크닉스는 1989년에 설립되어 2000년에 코스닥 시장에 상장한 레이저 장비 업체. 주요 장비로 반도체 레이저 마커, 레이저 어닐링, 레이저 커터, PCB 레이저 드릴러, 디스플레이 LLO, 2차 전지 노칭, 웰딩 장비 등이 있음. 2024년 전방 시장 기준 매출 비중은 반도체 55%, PCB 15%, 디스플레이 8%, 2차전지 1%, 서비스 및 기타 21%

장비, 고객사, 적용 공정 확대 중

DRAM 미세화와 HBM 및 NAND의 Hybrid Bonding 적용으로 레이저 어닐링의 적용 공정 확대와 고객 다변화가 기대. 현재 삼성전자에 1z nm DRAM부터 레이저 어닐링 장비를 독점적으로 공급 중. 미국 DRAM 업체와 평가를 진행 중으로 파악. 피코세컨드 그루빙 장비는 OSAT와 HBM 향으로 공급될 것. 신규 장비인 레이저 디본더는 생산성과 가격 경쟁력을 바탕으로 Foundry와 OSAT로 공급 중

매출액 성장과 수익성 개선 이루어질 2025년

2025년 동사의 실적은 매출액 3,796억 원(+18.3% YoY), 영업이익 653억 원(+109.4% YoY)을 전망. 어닐링 장비의 수요가 확대되고 그루빙 장비 매출액은 전년 대비 2배 성장이 기대. 레이저 마커 역시 HBM과 2nm 비메모리 수요가 예상. 그루빙 장비는 고객사의 도입 속도에 따라 실적 업사이드도 있다고 판단

Forecast earnings & Valuation

	2021	2022	2023	2024	2025F
매출액(억원)	3,909	4,472	3,163	3,209	3,796
YoY(%)	20.2	14.4	-29.3	1.5	18.3
영업이익(억원)	781	928	309	312	653
OP 마진(%)	20.0	20.8	9.8	9.7	17.2
지배주주순이익(억원)	719	765	366	428	594
EPS(원)	5,835	6,212	2,973	3,478	4,824
YoY(%)	236.7	6.5	-52.1	17.0	38.7
PER(배)	20.5	10.7	51.4	40.0	30.5
PSR(배)	3.8	1.8	6.0	5.3	4.8
EV/EBITDA(배)	15.6	6.5	43.7	40.2	21.4
PBR(배)	3.1	1.5	3.4	2.9	2.8
ROE(%)	16.3	15.1	6.7	7.4	9.5
배당수익률(%)	0.8	1.5	0.3	0.4	0.3

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (6/10)	147,200원
52주 최고가	210,000원
52주 최저가	113,100원
KOSDAQ (6/10)	771.20p
자본금	62억원
시가총액	18,134억원
액면가	500원
발행주식수	12백만주
일평균 거래량 (60일)	10만주
일평균 거래액 (60일)	131억원
외국인지분율	21.05%
주요주주	성규동 외 10 인 31.09%
	Baillie Gifford Overseas Limited 외 1 인 8.47%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	25.9	12.7	-25.7
상대주가	18.0	-3.3	-16.7

▶참고 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '이자보상배율', 성장성 지표는 'EPS증가율', 수익성 지표는 '영업이익률', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

▶글로벌 세그먼트는 코스닥 시장 내 재무실적과 시장평가, 기업지배구조가 우수한 기업으로 한국거래소에서 선정된 기업



기업 개요

이오테크닉스는 반도체 및 디스플레이 레이저 장비 업체

**이오테크닉스는 1989년 설립되어
2000년 코스닥 상장한
반도체 및 디스플레이 장비 업체**

이오테크닉스는 1989년 설립된 레이저 응용장비 전문 제조기업으로, 전자광학(Electro-Optics) 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, PCB 등의 정밀 가공 장비를 독자 기술로 개발해왔다. 창립 초기에는 국내 제조업의 자동화 및 정밀화 수요 확대에 따라 레이저 마킹 및 절단 장비에 기술 역량을 집중하였으며, 2000년 코스닥 상장을 통해 본격적인 외형 성장의 발판을 마련했다.

2000년대 초반에는 반도체 패키징 공정에 특화된 레이저 마킹 장비를 중심으로 시장을 확대했고, 이후 레이저 커터와 드릴러 등으로 제품 라인업을 확장하였다. 이오테크닉스는 레이저 빔 제어, 열영향 최소화, 다중 레이저 가공 등 공정 정밀도를 향상시키는 핵심 기술을 고도화하며 기술 차별화를 이뤄냈다. 2010년에는 중국 소주에 현지 생산법인을 설립하며 글로벌 생산 체계를 구축했고, ISO 9001 인증과 고신기술제품 선정을 통해 품질 및 기술 신뢰도를 확보하였다. 2014년에는 일억불 수출의 탑을 수상하며 글로벌 수출 경쟁력을 입증했고, 이를 계기로 중국, 동남아, 미국 등으로 고객 기반을 다변화하였다. 이후에는 OLED, 고해상도 디스플레이, 3D 센서 등 차세대 전자부품 수요에 대응하여 디스플레이 및 정보통신용 고정밀 레이저 장비 개발에 집중하였다. 다중 빔 동시 가공, 비접촉식 마킹, 미세절단 공정 등 고부가가치 기술을 상용화하며 제품 경쟁력을 강화했고, 이를 통해 주요 고객사인 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 대형 전자부품 제조사에 공급을 확대하였다.

2020년에는 '반도체의 날' 대통령 표창을 수상하며 반도체 공정 분야에서의 기술력을 대외적으로 인정받았으며, 이후에도 반도체 미세공정 대응을 위한 고정밀 레이저 가공장비의 성능 향상에 지속적으로 투자하고 있다. 최근에는 초미세 회로 및 초고해상도 디스플레이 구현을 위한 정밀 가공 수요가 증가함에 따라, 기존 장비의 커스터마이징, 신규 장비 개발, 글로벌 기술지원 체계 강화 등을 통해 시장 대응력을 제고하고 있다. 기술 중심의 경영 기조를 바탕으로 특허 중심의 지식재산권 확보 전략을 추진하여 기술 진입장벽을 강화하고 있으며, 2022년부터는 글로벌 세그먼트 지수(Global Segment Index)에 편입되며 글로벌 기술기업으로의 입지를 공고히 하고 있다.

주요 연혁

1989~2004 창업 및 시장 진출	2005~2011 성장 및 핵심 기술 추구	2012~ 글로벌 리더십 경쟁
1989 이오테크닉스 설립 1993 법인전환 1994 기업부설연구소 설립 1996 국산신기술 인정(KT마크) 획득(과학기술처) 유망 선진 기술 기업 지정 (중소기업청) 1997 정밀기술 경진대회 중소기업청장상 수상 1998 벤처기업 등록 필리핀 지사 설립 ISO 9001/FDA 인증 BM Mark 획득 (통상산업부) 우수품질 인증제품 국무총리상 수상 경기도 유망중소기업 선정 1999 BMTech 설립 싱가포르 현지법인 설립 미국 현지 법인 설립 2000 KOSDAQ 상장 대만 법인/태국, 인도네시아 지사 설립 CE/S2 인증 획득 1천만불 수출탑 수상 대통령 표창 세계일류상품 생산기업 선정(산업자원부) Cypress Semiconductor 우수 공급자상 2001 한국 World-Class 제품상 수상 (산업통상자원부) 세계일류상품 지정 (산업통상자원부) 2002 SEM 인증획득(CSM) CE 인증획득 2003 중국천진 현지법인 설립 2004 신관건물 증축 완공 2천만불 수출탑 수상 경영실상 수상(CSM2000, CSM3000)	2005 3천만불 수출탑 수상 삼성전자 협력회사협의회 회원사 선정 삼성전기 협부회 회원사 선정 삼성전기 특별상 수상 2006 Laser Via Tech 설립 한국반도체연구조합 회원사 선정 2007 동탑산업훈장 수상(성규동 대표이사) Forbes 아시아 태평양지역 Best 200 중소기업 선정 2008 중국 소주 법인 설립 5천만불 수출탑 수상 2009 영국 Powerase 인수 Forbes 아시아 태평양지역 Best 200대 중소기업 선정 2010 7천만불 수출탑 수상 NET 신기술인증 (지식경제부) 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 지정 (중소기업청) 300억 자금 투자 유치, 칼리일 그로스코리아(Carlyle Growth Korea, LLC.) 수출강소기업 Plus 500 선정 IBK 수출탑 은상 수상 삼성전기와 Stop CO2 멘토링 협약 체결 2011 UTAC Group 우수 공급자 수상 중국 소주공장 준공 독일 Innovavent GmbH 인수 벤처매출 천억기업 수상 Forbes 아시아 태평양지역 Best 200대 중소기업 선정 Ernst & Young Entrepreneur Amkor Group 최우수장비상 수상 UTAC Group 우수 공급자 수상 OSE Group 우수 공급자 수상	2012 본사 사옥 이전 관양동 R&D 센터 준공 특허경영우수상 수상(특허청장 표창) KRX 히든챔피언 선정 KOTRA 글로벌 브랜딩 2012 금상 수상 삼성전자 혁신기술기업 협의회 회원사 선정 StatsChipPac Group 우수 공급자 수상 2013 EO Club 설립 경기도 성실납세자 인증 IBK 무역탑 금탑 Forbes 아시아 태평양지역 Best 200대 중소기업 선정 삼성전자 2013 올해의 강소기업 삼성전자 혁신우수 협력사 동상 LG이노텍 Winners Partner 상 ASE 반도체 우수공급자상 한국광학기기 기술상 2014 베트남 지사 설립 1억불 수출의탑 수상 산업혁신 3.0 표창대 수상 코스타 히든챔피언 선정(6년연속) SDC 혁신우수협력사 금상, 삼성전자 혁신우수협력사 지평선형 삼성인 특별상 SPIL 반도체 우수공급자상 OSE Group 우수 공급자 수상 삼성전기 동반성장대상 2015 IBK 컴월드 선정 알자리 창출 우수 기업 선정 한국생산기술연구원 퍼트너 기업 선정 OMM 레벨 3 인증 획득 2015 코스타 라이징 스타 선정 IBK 기업은행 제12회 기업인 명예의 전당 '현장자' 선정 World class 300 글로벌 전문기업 선정 Forbes 아시아 태평양지역 Best 200대 중소기업 선정(5회연속) SPIL Group 우수 공급자 수상 LGInnotek 협력사 우수상 수상 2017 한국형 히든챔피언 우수기업상 2017년 STEMCO 감사패 성실납세이행 금탑산업훈장 2016 Phoenix Pioneer Technology Best Partner 수상 2018 ASE Group, Outstanding Supplier 선정 서울대학교 감사패 OSE 우수공급자 선정 2018 코스타 라이징 스타 선정 2019 동반성장위원회 감사패 SDC 혁신우수협력사 대상 수상 고에-지연구위원회 감사패 2020 2020 코스타 라이징 스타 선정 대통령 표창 (반도체의 날) SEC 혁신우수협력사 금상 수상 SDC 공로상 한국반도체산업협회 감사패 삼성전기 혁신우수협력사 금상 수상 2021 2021 코스타 라이징 스타 선정 2022 코스타 라이징 스타 선정 KOPHA 올해의 경영인 삼성전자 감사패 안양시 시민대상 글로벌세그먼트 지수 편입 2023 코스타 라이징 스타 선정

자료: 이오테크닉스, 한국R협회의 기업리서치센터

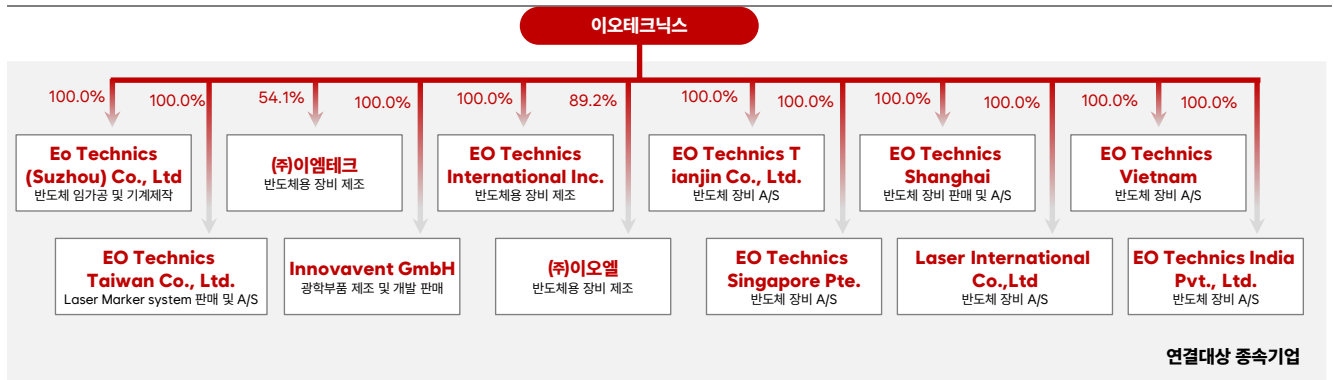
종속회사 현황

연결대상 종속기업은

비상장 12개사

이오테크닉스는 2024년 말 기준 총 12개의 비상장 종속회사를 연결대상으로 보유하고 있다. 이 중 Eo Technics (Suzhou) Co., Ltd.는 중국 내 생산 거점으로, 2024년 말 기준 지분율 100.0%, 자산총액 567억 원 규모이며, EO Technics Taiwan Co., Ltd.는 대만 지역에서 레이저 마커 시스템의 판매 및 A/S(애프터서비스) 사업을 수행하고 있으며, 지분율 100.0%, 자산총액은 188억 원이다. 또한, Innovavent GmbH는 독일 소재의 광학 부품 제조 및 개발 전문 기업으로, 지분율 100.0%, 자산총액 98억 원이며, 기술 기반의 유럽 시장 대응을 위한 전략적 거점 역할을 수행하고 있다. 이 외 나머지 9개의 종속회사 역시 대부분 반도체 장비의 해외 판매 및 유지보수(A/S) 사업을 중심으로 운영되고 있으며, 이오테크닉스의 글로벌 고객 대응력 및 현지 기술지원을 강화 목적으로 운영되고 있다.

이오테크닉스 지분도



주: 2024년말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

주요 사업 및 매출 구성

2024년 매출 비중은

반도체 55%, PCB 15%,

디스플레이 8%, 2차전지 1%,

서비스 및 기타 21% 기록

동사의 주요 사업은 반도체 레이저 마커, 레이저 어닐링, 레이저 커터, PCB 레이저 드릴러, 디스플레이 LLO, 2차전지 노칭, 웰딩 장비 등이 있다. 2024년 전방 시장 기준 매출 비중은 반도체 55%, PCB 15%, 디스플레이 8%, 2차전지 1%, 서비스 및 기타 21%의 구성을 보인다. 2024년 기준 수출 비중은 48.7%를 기록하였다.

<반도체>

레이저 마커

동사의 핵심 장비로 가장 큰 매출 비중을 차지하는 장비군이다. 반도체 레이저 마커(Marker)는 국내 95%, 해외 60%의 시장 점유율을 보이고 있다. 레이저 마킹은 고출력 레이저 빔을 재료 표면에 집속시켜 열 변형, 제거(Ablation), 발포(Foaming) 등의 물리적, 화학적 변화를 통해 원하는 정보를 새기는 기술이다. 전통적인 물리적 접촉 방식과 달리 비접촉 방식으로 작업이 이루어져 반도체와 같은 정밀 부품의 손상 위험이 없다는 장점이 있다. 동사의 장비는 반도체 패키지 표면에 제조사, 모델 번호, 로트 번호 등을 표시하는 레거시 마커와 각 웨이퍼와 개별 다이(Die)에 웨이퍼 ID, 로트 정보 등 기록하여 고유하게 식별하여 제조 공정 전반에 걸친 로트 추적 및 불량 분석, 고객사별 웨이퍼 식별이 가능하게 하는 웨이퍼 마커로 크게 구분할 수 있다.

레이저 어닐링

반도체 레이저 어닐링(Laser Annealing) 장비는 반도체 제조 공정에서 웨이퍼의 결정 구조를 복원하거나 불순물을 활성화하기 위해 레이저를 이용해 웨이퍼 표면을 국소적으로 가열 및 냉각하는 장비이다. 이온 주입(Ion Implantation) 후 발생한 결정 손상을 복구하고 도펀트(Dopant)를 활성화하는 열처리 공정이다. 기존에는 퍼니스(Furnace)나 급속 열처리(RTP, Rapid Thermal Processing) 방식이 사용되었으나 웨이퍼 전체에 열을 가하는 방식은 얇은 막질에서는 열에 의한 변형이나 불량 발생 위험이 높다. 레이저 어닐링은 웨이퍼 결함부에 국소적으로 레이저를 조사해 열처리하는 방식으로 짧은 가열 시간으로 불순물의 과도한 확산을 방지하고 얇은 반도체층 형성 가능하여 미세 공정에서 수율 개선에 기여할 수 있다. 동사의 장비는 1znm DRAM부터 적용되기 시작하였다. 고객사로는 삼성전자, 경쟁사로는 디아 이티가 있다.

레이저 커터

레이저 커터(Cutter)는 반도체 후공정에서 웨이퍼를 개별 칩으로 분리하는 싱글레이션 공정에서 사용되는 장비이다. Stealth Dicing, Grooving, Full Cutting 등을 포함한다. 레이저 커팅은 수 μm 수준의 정밀 절단 가능하며 미세 공정에 적합하고 물리적인 블레이드 커팅 대비 웨이퍼 손상이 적은 장점이 있다. 주요 경쟁사로는 일본의 Dicso가 있다.

<PCB>

레이저 드릴

레이저 기술을 활용해 PCB에 Via Hole, Through Hole, Blind Via 등을 정밀하게 가공하는 장비이다. CO2 레이저(파장 9.3~10.6 μm) 또는 UV 레이저(파장 355nm)를 사용하여 PCB에 홀을 가공한다. 경쟁사로는 일본 Mitsubishi, Hitachi, 미국 ESI가 있다.

<디스플레이>

LLO

OLED용 LLO(Laser Lift-Off) 장비는 Flexible OLED 제조에 필수적인 장비다. LLO는 레이저를 이용해 Carrier Glass에서 Flexible 패널을 분리하는 공정으로, Flexible 디스플레이 제조의 핵심 기술이다. 레이저 에너지가 PI(폴리이미드) 필름과 유리 기판 사이의 릴리스 레이어를 선택적으로 분해하여 필름을 분리한다. 주요 경쟁사로는 AP시스템, 주요 고객사로는 LG디스플레이가 있다.

<2차전자>

노칭

노칭(Notching) 장비는 2차 전지 제조의 전극 공정에서 양극 및 음극 전극판(주로 알루미늄 및 구리 포일)을 일정한 형태로 절단하여 탭(Tab)이나 특정 패턴을 형성하는 장비이다.

웰딩

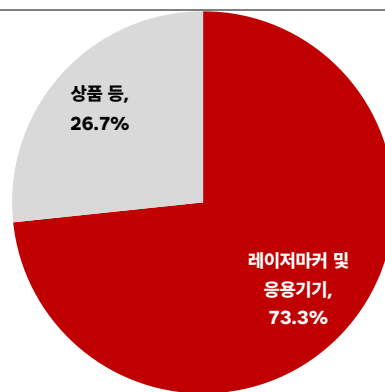
웰딩(Welding) 장비는 2차 전지 조립 공정에서 전극판의 탭(양극: 알루미늄, 음극: 구리)을 배터리 셀의 단자 또는 케이스에 접합하는 장비이다.

이오테크닉스 주요 제품



자료: 이오테크닉스, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 매출 비중



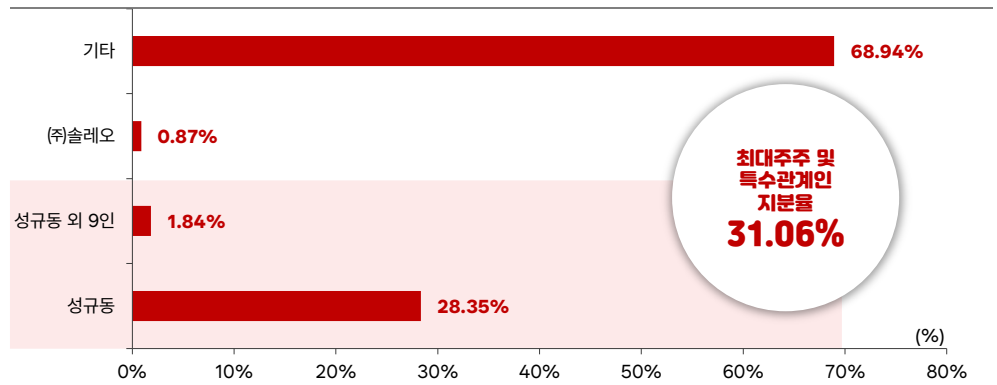
주: 1Q25 기준, 자료: 이오테크닉스, 한국IR협회의 기업리서치센터

주주 구성

최대주주는 대표이사 성규동으로 지분율 28.35% 보유

이오테크닉스의 최대주주는 성규동 대표이사로서, 개인 지분 28.35%를 보유하고 있으며, 성 대표를 포함한 최대주주 및 특수관계인의 지분 합계는 31.06%이다. 성 대표는 서울대학교 전기공학도를 졸업하고 동 대학원에서 석사 학위를 취득했으며, 금성중앙연구소, 대우중공업 기술연구소, 코리아레이저 등을 거쳐 1989년 이오테크닉스를 설립했다. 창업 이후 세계 최초로 펜 타입 레이저 마킹 장비를 개발하였고, 현재는 한국반도체산업협회 이사로도 활동하고 있다.

이오테크닉스 주주 현황



주: 2025년 3월말 기준, 자료: Dory, 한국IR협회의 기업리서치센터



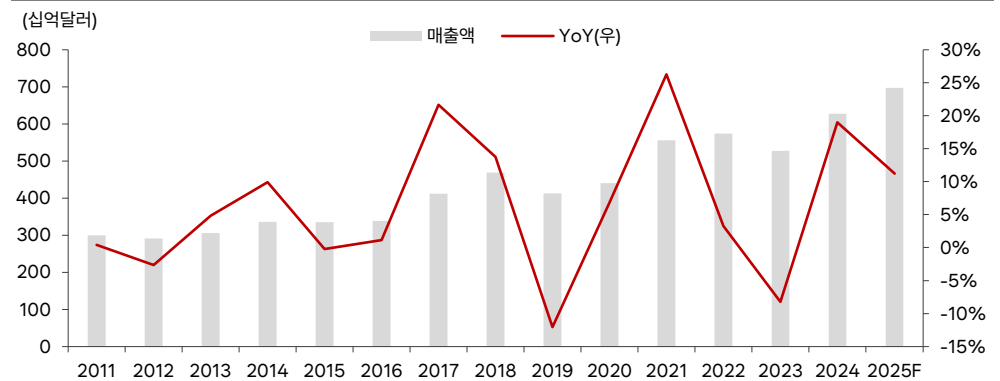
산업 현황

2025년 글로벌 반도체 CAPEX는 증가 전망

글로벌 반도체 시장은 메모리와 비메모리 Logic이 성장을 주도하며, 2024년 19.0%, 2025년 11.2% 성장 전망

글로벌 반도체 시장은 2023년 5,269억 달러에서 2024년 6,269억 달러(+19.0% YoY), 2025년 6,972억 달러(+11.2% YoY)까지 성장할 전망이다. 2024년 반도체 시장은 전년 대비 81.0% 성장한 메모리가 주도했다. 2024년 비메모리 시장은 전년 대비 5.8% 성장한 것으로 보이며, 이 중 Logic 시장이 전년 대비 16.9% 성장하며 비메모리 시장 성장을 견인한 것으로 추정된다. 2025년 역시 메모리와 Logic 시장이 각각 전년 대비 13.4%, 16.8% 성장하며 반도체 시장 성장(+11.2% YoY)을 이끌 것으로 예상된다.

글로벌 반도체 시장 규모 추이

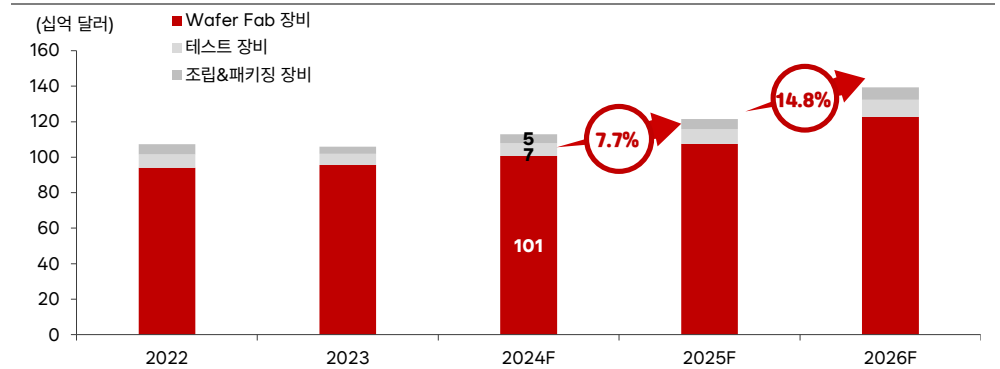


자료: WSTS, 한국IR협회의 기업리서치센터

2024~2026년 글로벌 반도체 장비 시장은 AI·HBM 수요와 선단 공정 전환에 따른 성장 기대. 후공정 장비 시장도 회복세 보일 전망

글로벌 반도체 장비 시장은 2024년 1,128억 달러(+6.5% YoY)에서 2025년 1,215억 달러(+7.7% YoY), 2026년 1,394억 달러(+14.8% YoY) 성장할 것으로 전망된다. 2024년 Wafer Fab 장비 시장은 AI 수요 강세로 인해 DRAM 및 HBM 장비 투자가 지속되고 중국의 투자 확대로 전년 대비 5.4% 성장하였다. 향후 하이엔드 로직 및 메모리 수요 증가로 전년 대비 2025년은 6.8%, 2026년은 14.0% 증가할 것으로 예상된다. 2년간 감소세를 보인 ①후공정 장비 시장은 2024년 하반기부터 회복세를 보이고 있다. 구체적으로 2024년 테스트 장비 시장은 전년 대비 14.6%, 조립 및 패키징 장비 시장은 전년 대비 16.0% 성장하였다. 2025년에는 이를 상회해 각각 전년 대비 18.7%, 23.4%의 성장을 전망한다. 후공정 부문의 성장은 고성능 컴퓨팅을 위한 반도체 장치의 복잡성 증가와 모바일, 자동차 및 산업용 최종 시장에서의 수요 증가에 기인한다. ②Foundry 및 Logic용 장비는 선단 공정 수요 증가와 GAA 전환 등의 영향으로 2025년 2.8%, 2026년 15% 성장할 것으로 예상된다. ③DRAM 장비 판매는 2024년 전년 대비 35.3% 성장한 188억 달러를 기록했으며, 2025년과 2026년에는 각각 전년 대비 10.4%와 6.2%의 연간 성장률을 기록할 것으로 전망한다. 이는 AI용 HBM 수요 증가와 Tech node migration(첨단 공정 전환) 지속 때문이다. 대부분 지역의 장비 지출은 2024년에 감소한 후 2025년에 회복될 것으로 예상되나, 중국은 지난 3년간 상당한 투자 이후 2025년에는 위축될 가능성이 높다. 그러나 2026년에는 다시 증가할 것으로 전망된다.

글로벌 반도체 장비 시장 규모 추이



자료: SEMI, 한국IR협회의 기업리서치센터

추론 AI 수요 빠르게 확대 중

**AI 수요 강세 속 추론 중심의
워크로드 전환과 AI 팩토리 확산,
빅테크 CAPEX 증가가 서버 및
반도체 수요 확대를 견인 중**

수요처별로 AI 강세는 지속되고 있다. 최근 AI 워크로드는 기존의 학습 중심에서 실제 서비스를 구현하는 '추론' 중심으로 빠르게 전환되는 추세다. 이에 따라 AI 팩토리(AI 서비스를 운영하는 대규모 데이터센터) 구축 수요가 급증하고 있다. 2025년 5월 28일 NVIDIA의 실적 발표에 따르면, Data Center 부문 매출은 391억 달러로 전년 대비 73.3% 증가하였다. 특히 2024년 출시된 최신 GPU 아키텍처인 Blackwell이 전체 Data Center 매출의 약 70%를 차지하며 기존 Hopper 아키텍처에서의 전환이 대부분 완료되었다. 이는 AI 추론 수요의 급증이 실적 성장의 주요 동력임을 시사한다. Open AI, Microsoft, Google은 토큰 생성에서 급격한 발전을 경험하고 있다. Microsoft는 1분기에만 100조 개가 넘는 토큰을 처리했는데, 이는 전년 동기 대비 5배 증가한 수치이다. Azure OpenAI의 이러한 급격한 성장은 Microsoft 플랫폼 전반 AI 서비스에 대한 높은 수요를 보여준다. 즉 워크로드(학습, 추론, 데이터 처리 등 데이터센터나 서버에서 처리하는 작업)의 일부였던 추론 기능은 수익 창출 AI 서비스로 폭발적으로 성장하고 있다.

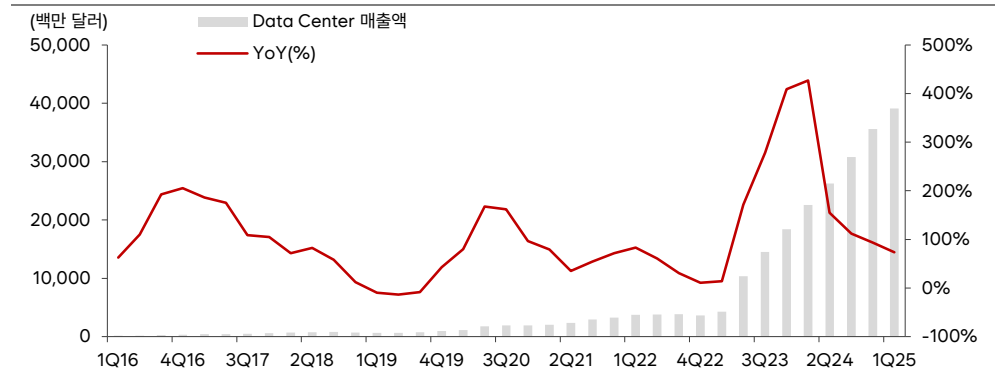
AI 팩토리도 구축 속도와 규모가 가속화되고 있다. 이번 1분기 Nvidia 기반 AI 팩토리는 약 100개에 달하며 전년 대비 2배 증가하였다. 각 AI 팩토리에 사용되는 GPU의 평균 개수도 같은 기간 동안 2배로 증가하였다. 또한 다양한 산업과 지역에서 더 많은 AI 팩토리 프로젝트가 시작되고 있다. AT&T, BYD, Capital One, Foxconn, MediaTek, Telenor와 같은 업계 선도 기업들이 최근 사우디아라비아, 대만, UAE에서 발표된 것처럼 전략적으로 중요한 소버린 클라우드를 구축함에 따라 AI 팩토리 수요가 크게 증가할 것으로 전망된다.

이러한 AI 인프라 확대 흐름은 글로벌 빅테크 기업들의 설비투자(CAPEX) 전망이 지속적으로 상향 조정되고 있다는 점에서도 확인된다. 미국 주요 Big Tech 4사의 2024년 CAPEX는 전년 대비 38.6% 증가한 2,173억 달러를 기록했으며, 2025년에는 이보다 43.0% 증가한 3,107억 달러에 이를 것으로 예상된다. 이처럼 공격적인 설비투자 확대는 향후 서버 수요의 견조한 흐름을 뒷받침하는 핵심 요인으로 작용할 전망이다. 2025년 글로벌 서버 출하량은 전년 대비 5.1% 성장할 것으로 예상되며, 전통적 서버(Traditional Server)와 AI 서버(AI Server) 모두에서 수요 증가가 동시에 나타날 것으로 보인다.

PC 시장은 윈도10 지원 종료(2025년 10월)와 AI PC 수요로 하반기 회복이 예상된다. AI 애플리케이션을 지원 PC 확

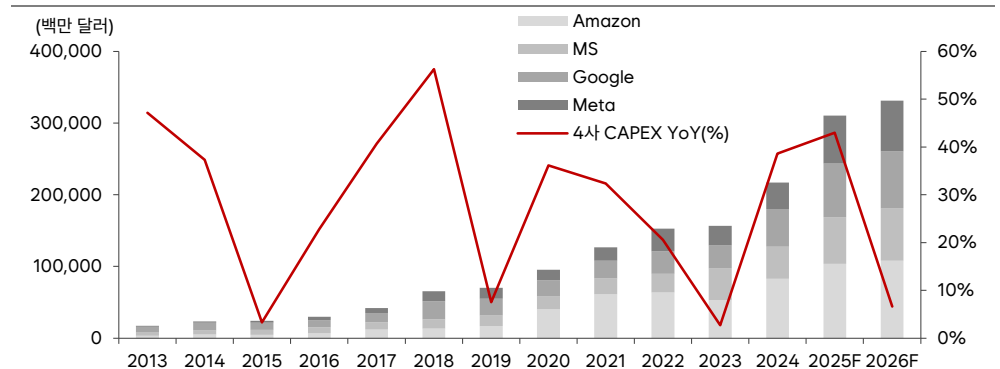
보 육구가 성장을 이끄는 촉매로 작용할 것으로 보인다. 스마트폰 시장은 계절적 비수기, 관세 불확실성으로 단기 수요가 약세이나, On-Device AI 확산으로 고용량 DRAM과 고성능 NAND 수요가 증가하고 있다. 중국 내수 회복으로 모바일 DRAM 수요가 개선될 것으로 전망되며, 2분기부터 고객 재고 정상화로 수요 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다. 또한, 중국 및 글로벌 OEM의 재고가 정상화될 것으로 전망되고 하반기에는 DRAM 및 NAND 출하량이 증가할 것으로 예상된다.

Nvidia Data Center 매출액 추이



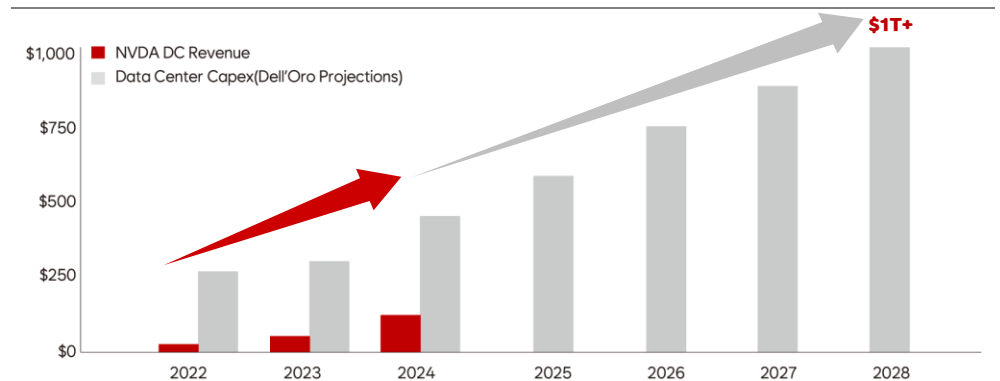
자료: Nvidia, 한국IR협회의 기업리서치센터

Big Tech CAPEX 추이



자료: Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

Data Center CAPEX 전망



자료: Nvidia, 한국IR협회의 기업리서치센터



투자포인트

1 어닐링 적용 공정 확대 기대

**어닐링(열처리, Annealing)은
이온주입으로 손상된 웨이퍼
구조를 회복하고 도판트를
활성화하기 위한 공정**

동사 어닐링(Annealing) 장비의 적용 공정 확대가 기대된다. 이온 임플란트(Ion Implantation) 공정은 반도체 제조 과정에서 웨이퍼에 특정 불순물(Dopant)을 주입해 전기적 특성을 조절하는 공정이다. 해당 공정은 실리콘 표면의 깊은 영역에 Well을 형성하거나, 트랜지스터의 문턱전압(Channel Vt)을 조절하며, Source 및 Drain 영역에 고농도로 이온을 주입하는 등 기술 발전에 따라 보다 많은 목적으로 이온주입공정이 사용되고 있다. 이온주입은 높은 충돌 에너지로 인해 웨이퍼 표면의 결정 구조를 손상시킨다. 이 과정에서 실리콘의 결정격자가 불순물 주입으로 인해 공유결합이 끊기고, 결정질 실리콘이 비정질 상태로 변하게 된다. 또한, 이온 주입량이 증가할수록 비정질층의 두께 역시 두꺼워지는 특징이 있다.

이온주입된 도판트(Dopant)가 실리콘과 결합하여 자유 전자 또는 정공을 가지기 위해서는 일정량의 열처리 공정이 필요하다. 이온주입 후 600~1,000°C의 열처리(Annealing)를 통해 격자 손상을 회복시키고 비정질화된 영역을 재결정화한다. 도판트들은 열처리를 통해 실리콘 결정의 치환형 자리에 위치하게 되어 전기적으로 활성화(Activation)된다.

**기존 어닐링 공정의 열 확산
한계를 보완하기 위해, 국소
가열로 수평 확산을 최소화하는
초고속 레이저 어닐링(Laser
Annealing) 기술이 주목**

기존 어닐링 공정에는 퍼니스(Furnace)나 급속 열처리(RTP, Rapid Thermal Processing) 방식이 주로 사용되었다. 그러나 기존의 방식은 웨이퍼 전체에 열을 가하는 방식이기 때문에, 박막 구조에서는 열에 의한 변형이나 불량 발생 위험이 높다는 단점이 있다. 또한, 반도체 공정의 미세화로 이온주입 공정에서는 얇고 고농도의 접합(Junction) 형성이 요구되지만, RTA 방식으로는 열 확산을 통한 수평 확산(Lateral Diffusion) 제어에 한계가 존재한다. 이에 따라 최근에는 초고속 레이저 어닐링(Laser Annealing) 기술이 주목받고 있으며, 국소 영역만을 빠르게 가열함으로써 열 확산을 최소화한다.

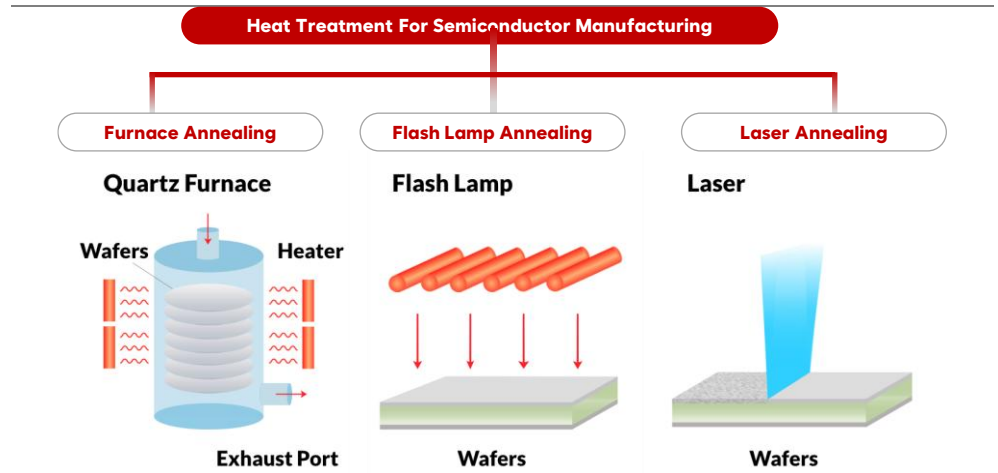
**레이저 어닐링은 Hybrid
Bonding 확산에 따라 HBM과
고단화 NAND 공정에서 필수
기술로 자리잡을 전망**

레이저 어닐링은 이온 임플란트 공정 외에도 HKMG(High-k Metal Gate, 누설전류 감소 기술), 금속 콘택트(Cu-W), 절연막(Low-K) 등 스트레스 완화 및 저온 보정 공정에도 사용된다. 각 금속 재료는 열팽창계수가 달라 식으면서 인장, 압축 응력이 남고 이는 게이트 변형, Void 형성 및 콘택트 저항 증가 등 수율을 저해하는 요소가 된다. 레이저 어닐링을 통해 HKMG 주변 스트레스 제어와 박막 Cu의 Void를 제거한다. 향후 HBM4E에 적용이 예상되는 Hybrid Bonding에도 Cu-Cu 접합에 있어 스택 수 증가로 미세 Void 및 열응력이 증가하고 고온의 RTP 적용이 어려워 레이저 어닐링이 필수적이다. 향후 고단화 NAND의 Hybrid Bonding 공정에도 RTP를 대체할 가능성이 있다 판단된다.

**동사는 DRAM 미세화 및 Hybrid
Bonding 확대에 따라 적용
공정과 고객사의 다변화가 기대**

동사는 현재 삼성전자에 1z nm DRAM부터 레이저 어닐링 장비를 독점적으로 공급하고 있다. 동사는 미국 DRAM 업체와 평가를 진행 중으로 파악된다. 향후 DRAM 미세화와 HBM 및 NAND의 Hybrid Bonding 적용으로 레이저 어닐링의 적용 공정 확대와 고객 다변화가 기대된다.

어닐링 종류



자료: Mechatronics, 한국IR협회의 기업리서치센터

그루빙 장비 본격 시장 침투

웨이퍼 절단 공정의 고도화에 따라
동사의 레이저 기반 커팅 장비는
기존 블레이드 방식의 한계를
보완하며 고객사 확대가 기대

동사 반도체 커팅 장비의 고객사 확대가 기대된다. 웨이퍼 다이싱(Dicing)은 반도체 제조 후, 백 그라인딩(Back Grinding)을 거친 얇은 웨이퍼를 칩 단위로 잘라내는 공정이다. 이때 웨이퍼 위에는 ‘스크라이브 라인(Scribe Lane)’이라는 칩 사이 공간이 미리 설정되어 있는데, 이 부분을 절단해 각 칩을 개별 패키지 공정으로 넘기게 된다. 웨이퍼 절단 방법에는 블레이드 다이싱, 레이저 다이싱, 플라즈마 다이싱이 있다. **블레이드 다이싱**은 절삭날(Blade)이 직접 웨이퍼에 닿아 물리적으로 잘라내는 방식으로, 오랜 기간 널리 쓰인 전통적인 방식이다. 빠른 속도로 많은 양의 웨이퍼를 처리할 수 있는 장점이 있지만, 열과 파편(Debris)이 발생하고, 절단 속도를 과도하게 높일 경우 외부 손상으로 인해 칩 모서리가 깨지는 칩핑(Chipping) 현상이 나타날 수 있다. 특히 웨이퍼가 얇아질수록 칩핑과 미세 균열(Crack) 문제가 더욱 심해진다.

레이저 다이싱은 레이저 빔을 사용하여 웨이퍼를 정밀하게 절단하는 비접촉식 방법이다. 보통 마운팅 테이프에 웨이퍼를 붙이고 웨이퍼 뒷면에서 레이저를 조사하여 웨이퍼를 절단한다. 레이저 다이싱은 최소한의 열적 영향을 주며, 고속으로 작은 커프 폭(kerf width)을 제공하여 정밀도가 높다. 또한 비접촉 방식으로 기계적 스트레스를 줄여 웨이퍼 손상을 방지한다. 하지만 웨이퍼 두께가 100 μ m 이상인 경우는 생산성이 낮기 때문에 그 이하 규격(얇은 두께)의 웨이퍼에서 많이 사용된다. 동사의 레이저 다이싱은 크게 그루빙(Grooving), 스텔스(Stealth) 다이싱, 풀 커팅 다이싱으로 구분할 수 있다. 이 중 그루빙은 비메모리에 주로 사용되고 있으며 메모리에는 스텔스 다이싱이 사용된다. **플라즈마 다이싱**은 액체가 아닌 준기체상태의 플라즈마를 이용해 웨이퍼를 절단하는 방식으로, 블레이드 다이싱이나 레이저 다이싱처럼 물리적 접촉이나 열에 의한 손상이 발생하지 않는다. 이에 따라 칩 모서리 손상, 균열 등 외부 데미지가 없으며, 불량률을 줄이고 칩 수율을 높일 수 있는 장점이 있다.

동사의 레이저 그루빙 다이싱은
Low-k 막 손상 줄이고, 비메모리
반도체의 정밀 절단 가능

동사의 그루빙(Grooving) 다이싱은 웨이퍼 표면에 레이저로 얇은 홈(Groove)을 먼저 만든 후, 그 홈을 따라 다이아몬드 블레이드로 풀 커팅하는 방식이다. 이 방식은 Low-k 막과 같은 특정 구조를 제거하거나 절단 품질을 높이기 위해 사용된다. 특히 비메모리 반도체의 경우 신호 지연을 줄이기 위해 저유전율 재료인 Low-k 막이 많이 사용되는데, 이

막은 기계적 강도가 낮아 일반적인 블레이드 다이싱으로는 박리(Delamination) 위험이 크다. 게다가 비메모리 제품은 다이싱 라인에 복잡한 테스트 구조나 금속 배선이 포함되어 있는 경우가 많아, 보다 정밀한 절단이 가능한 레이저 그루빙 공정이 필수적으로 적용된다.

**스텔스 다이싱은 칩 손상 없이
얇은 웨이퍼를 정밀하게 분리할 수
있어, 메모리 반도체 내 채택 확대**

스텔스(Stedth) 다이싱은 웨이퍼 내부에 레이저를 집속하여 개질층(Modified Layer)을 형성한 뒤, 외부 힘(예: 테이프 확장)을 가해 칩을 분리하는 방식이다. 후면에 부착된 테이프에 압력을 가하면 확장된 테이프에 의해 웨이퍼가 순간적으로 위로 휘어지면서 칩들이 개별로 상굴레이션된다. 레이저로 표면을 직접 다이싱할 때 생기는 부스러기가 없고, 잘리는 라인 폭인 커프(Kerf)가 좁아 웨이퍼 상에 많은 칩을 넣을 수 있다. 또한 전반적인 다이싱 품질을 결정짓는 칩 핑 및 크랙 발생량도 적은 장점이 있다. 따라서 기계적 스트레스 없이 이러한 얇은 웨이퍼를 분리하는 데 적합하고 좁은 커프 폭을 제공해 웨이퍼 면적 활용도를 높이고 더 많은 칩을 생산 가능함으로 메모리에서의 활용도가 높다.

**레이저 풀커팅 다이싱은 초박형
웨이퍼를 빠르고 정밀하게 절단할
수 있어, HBM4 등 고정밀 메모리
공정에서 수요 확대가 기대**

레이저 풀커팅 다이싱은 레이저를 이용해 웨이퍼의 전체 두께를 한 번에 절단하는 방식의 다이싱 기술이다. 이 공정은 두께 200 μ m 이하의 박형 웨이퍼(Thin Wafer) 상면, 즉 패턴면에 레이저를 한 번 또는 여러 차례 조사해 하부 테이프까지 절단함으로써 웨이퍼를 칩 단위로 분리한다. 해당 방식은 절삭 속도를 크게 높일 수 있어 처리율이 향상되며, 기계적인 스트레스가 발생하지 않아 초박형 웨이퍼나 화합물 반도체를 절단하는 데 유리하다. 특히 HBM4와 같이 웨이퍼가 매우 얇고 정밀도가 요구되는 공정에서는 블레이드 다이싱보다 빠르고 안정적인 절단이 가능해, 향후 레이저 풀커팅 장비의 수요가 본격적으로 확대될 것으로 기대된다.

**극초단 레이저 기술을 내재화한
동사는 펨토 피코세컨드 장비
경쟁력을 바탕으로 Apple
M시리즈 및 HBM향 수요를
확보하며 커팅 장비 매출 성장
예상**

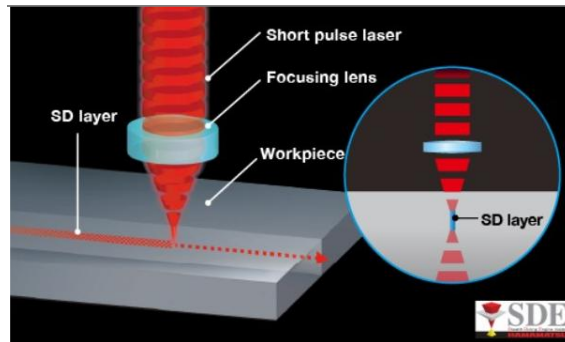
동사는 피코세컨드(Picosecond) 및 펨토세컨드(Femtosecond) 레이저 기술을 기반으로 레이저 다이싱 장비를 개발하고 있으며, 두 극초단 레이저 기술을 모두 세계 최초로 내재화한 업체이다. 커팅 장비 시장은 일본의 Disco가 과점하고 있다. Disco(일본)는 그라인딩 소모품 매출을 기반으로, 낮은 가격에 장비를 공급하며 높은 시장 점유율을 보이고 있다. 이에 반해 동사는 레이저 소스 내재화로 원가를 절감하였으며, 유지보수 비용 경쟁력을 가지고 있다. 특히 피코세컨드(펄스 지속 시간이 10⁻¹²초) 레이저 커팅 장비에 있어서는 동사가 약 30%의 점유율을 확보하고 있는 것으로 파악되며, 펨토세컨드(10⁻¹⁵초) 레이저 커팅 장비는 동사만이 상용화에 성공하였다. 동사의 피코세컨드 그루빙 장비는 Apple의 M4칩에 적용되었으며, M5에는 펨토세컨드 장비가 적용될 것으로 보인다. 또한 HBM에도 피코세컨드 커팅 장비가 공급된다. OSAT 업체와 삼성전자향 공급 확대로 인해 2023년 100억 원 초반, 2024년 200억 원 초중반이던 동사의 커팅 장비 매출액은 2025년 2배 이상 성장할 것으로 기대된다.

그루빙(Grooving) 다이싱 프로세스

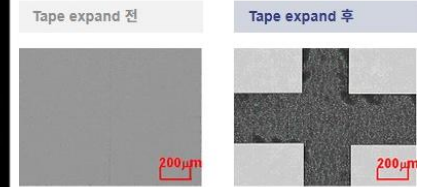


자료: Disco, 한국IR협회의 기업리서치센터

스텔스(Stealth) 다이싱 프로세스

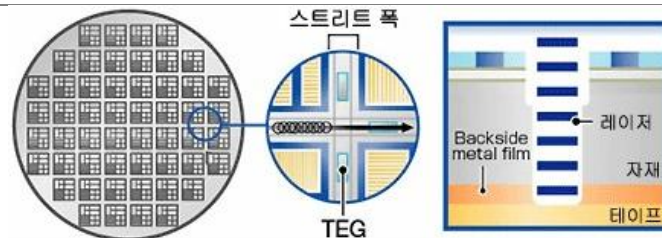


스텔스 다이싱 개략도



자료: Disco, 한국IR협회의 기업리서치센터

레이저 풀 커팅 프로세스



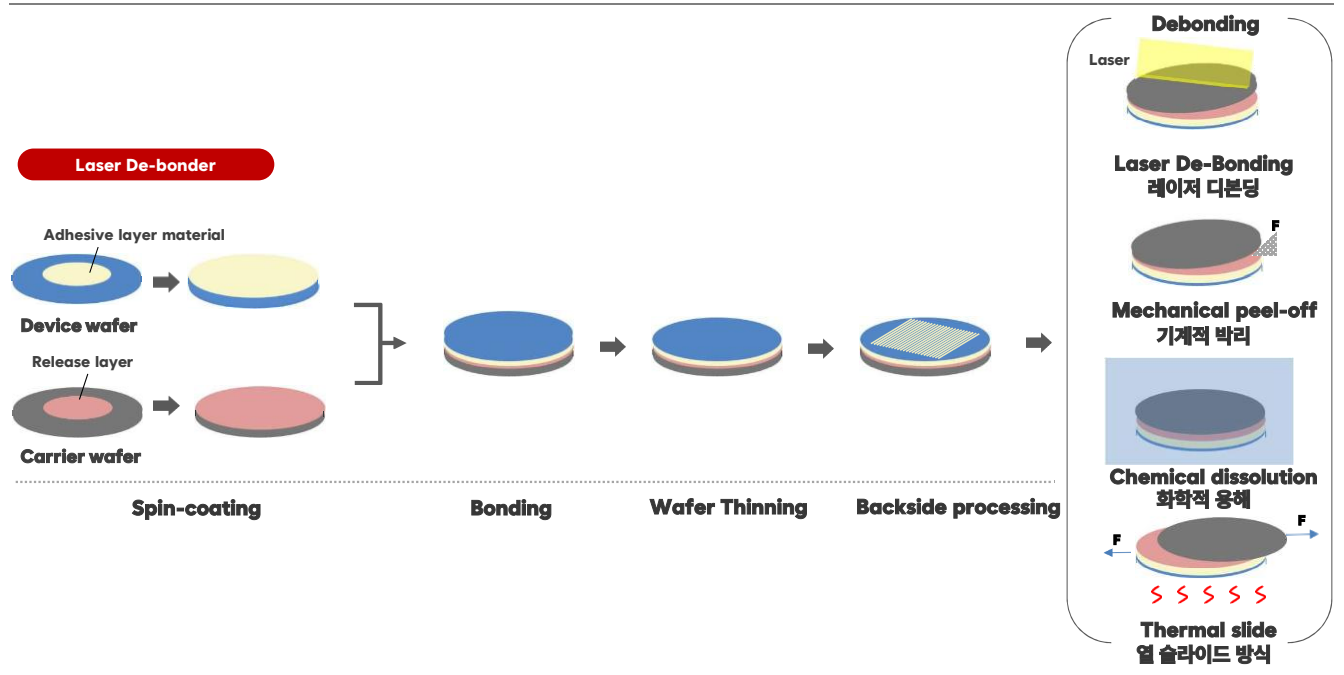
자료: Disco, 한국IR협회의 기업리서치센터

[3] 디본더로 이어지는 장비 다변화

동사는 레이저 기반 디본딩 장비를
통해 HBM·FOWLP·PLP 등 첨단
패키징 공정 확대에 대응하며,
해외 파운드리 및 국내 고객사로의
공급 확대 예상

동사의 신규 장비인 반도체 디본딩(Debonding) 장비의 공급이 기대된다. 디본딩은 HBM, TSV, FOWLP 등 고사양 패키징 공정에서 매우 얇은 웨이퍼를 보호하기 위해 유리나 캐리어 웨이퍼를 부착한 후, 후공정이 끝난 뒤 이를 다시 분리하는 과정이다. 디본딩 공정에서는 캐리어를 떼어낸 웨이퍼에 칩핑이나 깨짐, 균열, 접착제 잔여물이 없어야 하며 웨이퍼의 범프 변형이 생기지 않아야 한다. 디본딩 방법으로는 열 방식(Thermal), 레이저 방식, 화학적 용해 방식(Chemical Dissolution), 기계적 방식(Mechanical Lift Off) 등이 있다. 동사의 디본더는 레이저 방식으로, 레이저에 반응하는 접착제를 사용하여 글라스 캐리어의 후면에서 레이저를 투과시켜 접착제를 분해하고 본 웨이퍼를 손상 없이 분리하는 구조다. 해당 방식은 공정 온도가 200℃ 미만으로 낮아 얇은 웨이퍼에 열 스트레스를 유발하지 않으며, 칩핑, 크랙, 잔여물 없이 고품질로 분리할 수 있는 장점이 있다. 동사 장비는 이미 해외 OSAT 및 파운드리 업체에 공급되고 있으며, 일본 경쟁사 대비 낮은 가격과 높은 생산성으로 시장 점유율을 확대하는 중이다. 현재는 패널 레벨 패키지(PLP) 공정에도 대응할 수 있도록 장비 개발을 진행 중으로, 향후 PLP 시장 개화 시 국내 고객사로의 공급 확대가 기대된다.

레이저 디본딩



자료: MDPI, 한국IR협회의 기업리서치센터



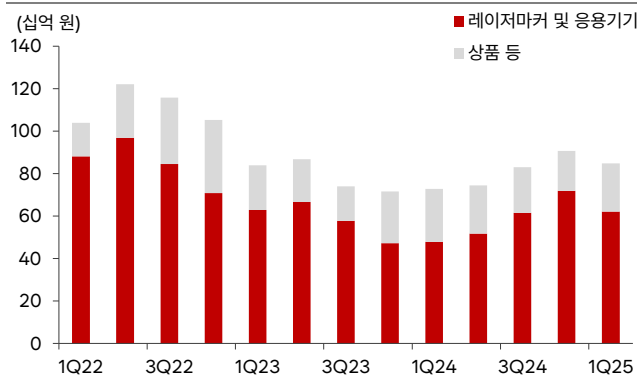
실적 추이 및 전망

2차전지 부진으로 매출액 성장 제한되었던 2024년

2024년 매출액 3,209억 원(+1.5% YoY), 영업이익 312억 원(+0.8% YoY) 기록

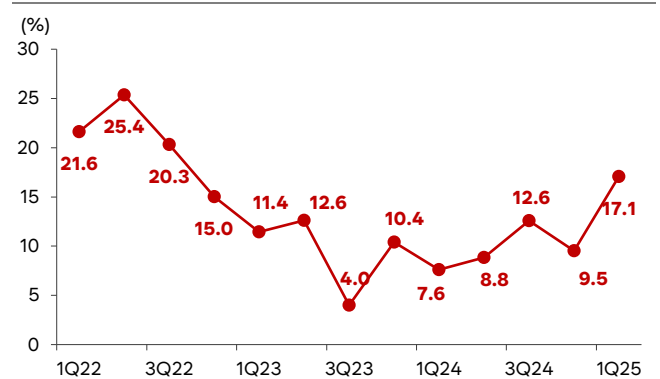
2024년 동사는 매출액 3,209억 원(+1.5% YoY), 영업이익 312억 원(+0.8% YoY)을 기록하였다. 분기별로는 상저하고 흐름을 보였으며, 이는 하반기 반도체 투자의 점진적 회복에 기인한다. 2024년 글로벌 반도체 CAPEX가 전년 대비 큰 폭으로 증가하지 않은 가운데, 동사의 반도체 매출 역시 제한적인 성장에 그쳤다. 다만, 후공정 장비 수요는 견조하였으며, 2021~2022년 공급된 장비에 대한 서비스 매출이 확대되었다. 제품별로는 피코세컨드 그루빙 장비 공급이 확대되며 커팅 장비 매출이 전년 대비 2배 이상 증가해 가장 큰 성장세를 보였다. 또한 PCB 드릴링 장비는 AI 수요 확대에 따른 기업업체의 설비투자 증가에 따라 견조한 매출을 유지하였다. 반면, 2차전지 및 디스플레이 부문은 2023년에 이어 업황 부진이 지속되며 장비 수요가 저조하였다. 수익성 측면에서는 2023년과 유사한 매출액 규모 및 매출액 구성으로 전년과 유사한 영업이익률 9.7%를 기록하였다.

이오테크닉스 부문별 실적 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

이오테크닉스 분기별 영업이익률 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

어닐링, 그루빙, 디본더 성장이 기대되는 2025년

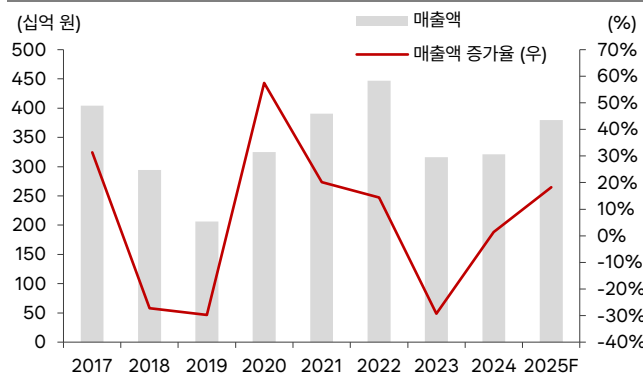
2025년 매출액 3,796억 원(+18.3% YoY), 영업이익 653억 원(+109.4% YoY) 전망

1Q25 동사는 매출액 848억 원(+16.5% YoY, -6.5% QoQ), 영업이익 145억 원(+161.0% YoY, +67.4% QoQ)을 기록하였다. 고객사의 1b, 1c nm DRAM 전환(10nm급 DRAM 공정 기술은 1x-1y-1z-1a-1b-1c 순으로 개발되었으며, 1b와 1c는 각각 5세대, 6세대 DRAM을 의미)으로 어닐링 장비 수요가 증가하였으며, 레이저 마커 장비 또한 견조한 실적을 보였다. 반도체 장비 매출 비중 확대에 따라 영업이익률은 17.1%로 전년 동기 대비 9.5%p 개선되었다.

2025년 동사의 연간 실적은 매출액 3,796억 원(+18.3% YoY), 영업이익 653억 원(+109.4% YoY)을 전망한다. 장비별로 살펴보면, 레이저 어닐링 장비는 DRAM 미세화 및 HBM, NAND의 Hybrid Bonding 적용 확대에 따라 공정 적용 범위가 넓어지고 고객사 다변화가 기대된다. 현재 미국 DRAM 업체와도 평가를 진행 중으로 파악된다. 그루빙 장비는 OSAT 및 삼성전자향 공급 증가로 전년 대비 약 2배의 매출 성장이 예상되며, 고객사의 도입 속도에 따라 추가적인 실적 업사이드 가능성도 존재한다고 판단된다. 레이저 마커는 HBM과 2nm 비메모리 반도체 관련 수요가 기대되며, 신규 장비인 레이저 디본더는 높은 생산성과 가격 경쟁력을 기반으로 해외 Foundry 및 OSAT 업체 중심으로 공급 확

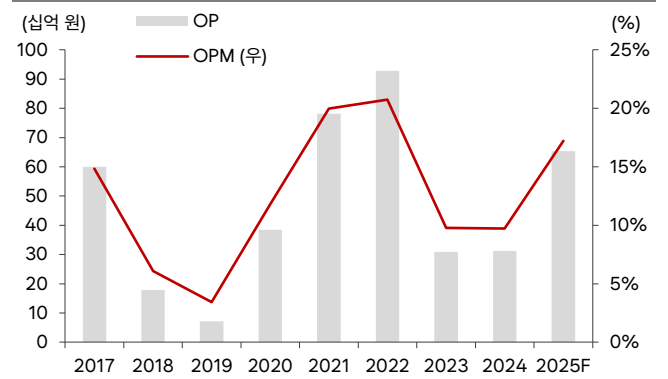
대가 전망된다. 수익성 측면에서는 매출액 확대와 상대적으로 고마진인 반도체 장비 매출 비중 증가로 전년 대비 7.5%p 개선된 영업이익률 17.2%를 전망한다.

이오테크닉스 매출액 및 매출액 증가율 추이



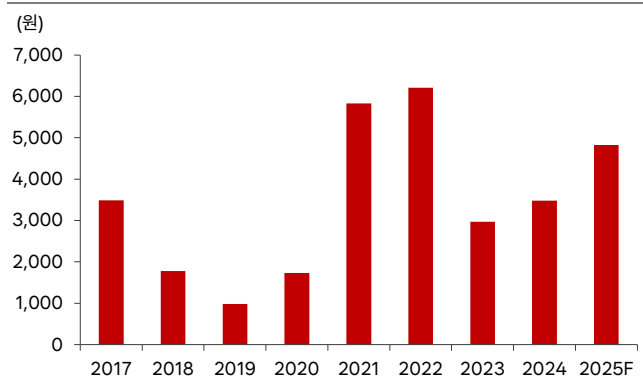
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

이오테크닉스 영업이익 및 영업이익률 추이



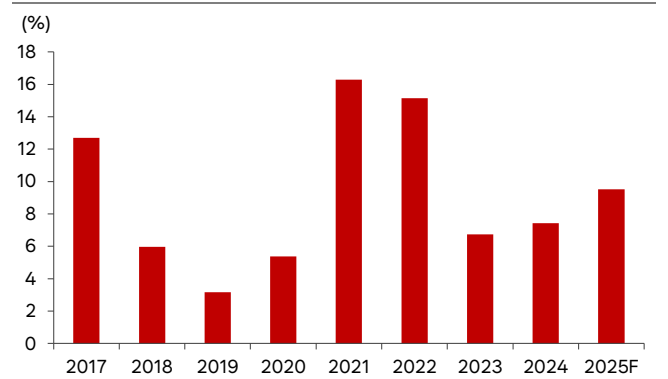
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

이오테크닉스 EPS 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

이오테크닉스 ROE 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

이오테크닉스 부문별 실적

(단위: 십억원)

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2022	2023	2024	2025F
매출액	103.9	122.2	115.8	105.3	83.9	86.9	74.0	71.6	72.8	74.4	83.0	90.7	84.8	447	316	321	380
레이저 마커 및 응용기기	88.1	96.9	84.5	70.9	62.9	66.6	57.7	47.2	47.8	51.8	61.6	71.9	62.2	340	234	233	288
상품 등	15.8	25.3	31.2	34.4	21.0	20.2	16.3	24.5	25.0	22.6	21.4	18.8	22.6	107	82	88	92
영업이익	22.5	31.0	23.5	15.8	9.6	10.9	3.0	7.5	5.5	6.6	10.4	8.6	14.5	93	31	31	65
지배주주순이익	20.1	24.7	30.8	0.9	13.6	12.5	8.0	2.5	10.6	10.9	4.9	16.5	14.4	77	37	43	59
Margin(%)																	
영업이익률	21.6	25.4	20.3	15.0	11.4	12.6	4.0	10.4	7.6	8.8	12.6	9.5	17.1	21	10	10	17
지배주주순이익률	19.4	20.2	26.6	0.8	16.2	14.4	10.8	3.5	14.6	14.6	5.9	18.2	17.0	17	12	13	16
YoY Growth(%)																	
매출액	26.4	6.0	7.0	23.6	-19.3	-28.9	-36.1	-32.0	-13.2	-14.3	12.2	26.6	16.5	14	-29	1	18
레이저 마커 및 응용기기	32.4	-1.3	-4.7	8.3	-28.6	-31.2	-31.7	-33.4	-24.0	-22.3	6.7	52.3	30.1	7	-31	-1	24
상품 등	0.9	47.9	60.4	74.0	32.4	-19.9	-48.0	-28.8	19.4	11.9	31.5	-23.2	-9.6	48	-23	7	4
영업이익	56.8	-0.8	0.3	73.8	-57.3	-64.7	-87.5	-52.8	-42.2	-39.9	253.3	16.0	161.0	19	-67	1	109
지배주주순이익	20.0	18.5	30.3	-91.8	-32.5	-49.3	-74.1	192.7	-21.9	-13.0	-39.2	551.8	35.7	6	-52	17	39
QoQ Growth(%)																	
매출액	22.0	17.5	-5.3	-9.1	-20.3	3.5	-14.8	-3.1	1.7	2.2	11.5	9.3	-6.5				
레이저 마커 및 응용기기	34.6	10.0	-12.8	-16.1	-11.3	5.9	-13.4	-18.2	1.2	8.3	18.9	16.8	-13.5				
상품 등	-19.8	59.4	23.7	10.0	-39.0	-3.6	-19.6	50.5	2.3	-9.6	-5.5	-12.1	20.4				
영업이익	147.4	37.8	-24.1	-32.9	-39.3	14.1	-73.0	152.5	-25.6	18.5	58.6	-17.1	67.4				
지배주주순이익	90.3	22.5	24.9	-97.2	1,473	-8.0	-36.1	-68.4	319.9	2.4	-55.3	239	-12.6				

자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

Valuation

2025F PER 30.5x

2025년 고객사 다변화 및 신규 장비 매출 증가에 따른 실적 성장, 유리기판 시장 개화에 따른 장비 공급 기대감이 Valuation 상승 여력으로 작용할 전망

동사의 현재주는 2025F PER 30.5x로 Historical PER Band(9.0x~90.0x) 중하단에 위치해 있다. 동사의 Peer 업체로는 레이저 장비 업체를 선정하였다. Peer 업체들 중 AP시스템을 제외하면 컨센서스가 존재하지 않으나, 과거 Valuation을 비교해보면 이오테크닉스는 Peer 업체들 대비 높은 Valuation을 부여받아 왔다. 이는 레이저 기술을 중심으로 어닐링, 커팅, 디본딩 장비 등 지속적으로 장비군과 적용 공정을 확대해 왔으며, 특히 전공정 장비인 어닐링 장비를 고객사에 독점적으로 공급하고 있다는 점에 기인한다. HBM용 레이저 어닐링 및 그루빙 장비에 대한 기대감이 한때 과도하게 반영되며 2024년 초 주가가 급등한 이후, 삼성전자의 HBM 공급 지연과 고밸류 부담으로 동사의 주가는 크게 하락하였다. 다만, 2025년에는 고객사 다변화와 신규 장비 확대 등을 통한 실적 성장이 예상되고, 반도체 장비 매출 확대도 기대된다. 또한 향후 유리기판 시장이 개화할 경우, 동사는 TGV형 레이저 장비 공급이 가능하다는 점에서 Valuation 확대 여지가 있는 것으로 판단된다.

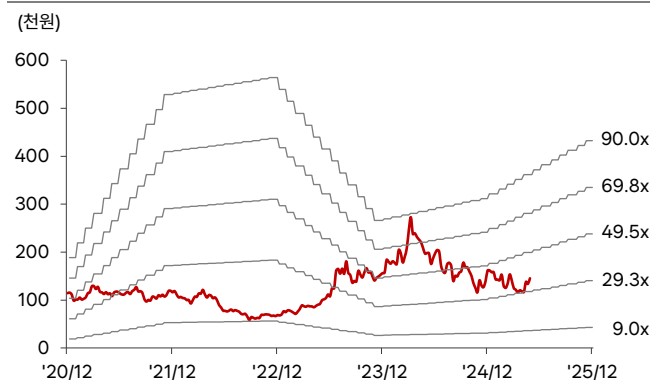
동종 업종 밸류에이션

기업명	종가 (원)	시가총액 (십억원)	매출액(십억원)			PER(배)			PBR(배)		
			2023	2024	2025F	2023	2024	2025F	2023	2024	2025F
코스피	2,872	2,288,026	3,517,716	3,720,962	3,005,486	-	-	10.4	-	-	0.9
코스닥	771	398,559	330,041	334,063	114,702	-	-	24.8	-	-	2.4
이오테크닉스	147,200	1,813	316	321	380	51.4	40.0	30.5	3.4	2.9	2.8
AP시스템	17,250	264	534	517	556	5.7	4.7	4.4	1.0	0.7	0.6
디아이티	13,430	254	107	117	-	26.4	8.2	-	1.8	1.1	-
필옵틱스	36,850	843	300	411	-	N/A	74.9	-	1.3	2.7	-
동종업종 평균						16.1	29.2	4.4	1.4	1.5	0.6

주: 2025년 06월 10일 종가 기준. 디아이티, 필옵틱스는 25F 컨센서스 없음. 동종그룹 25F는 시장 컨센서스 사용

자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 PER Band



자료: WiseFN, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 PBR Band



자료: WiseFN, 한국IR협회의 기업리서치센터



리스크 요인

1 삼성전자의 HBM 공급 여부에 따른 CAPEX 불확실성

해외 Foundry 및 OSAT항 장비
공급 확대 통한 동사의 고객
다변화 시도, 삼성전자의 HBM
역량 강화에 따라 리스크는
점진적으로 완화될 것으로 기대

동사의 리스크는 상대적으로 높은 삼성전자 매출 비중으로 판단된다. 과거 삼성전자의 반도체 Value Chain은 SK하이닉스의 Value Chain 대비 높은 Value를 받아왔으나, 삼성전자가 HBM 시장에서 기술을 선도하지 못하며 과거 대비 낮은 평가를 받고 있다. 이는 삼성전자의 지속적인 Nvidia로의 HBM 공급 이슈와 HBM 공급 지연에 따른 CAPEX 불확실성이 커졌기 때문으로 판단된다. 실제로 동사의 주가는 2024년 초 고점 형성 이후 삼성전자의 HBM 인증 불발로 인해 큰 폭의 하락을 기록하였다. 다만 동사는 그루빙 장비와 디본더를 기반으로 해외 Foundry 및 OSAT 업체로의 공급 확대를 추진 중이며, 이에 따라 삼성전자 매출 의존도는 점진적으로 완화될 것으로 예상된다. 또한 삼성전자 역시 HBM에 역량을 집중하고 있는 만큼, 현재 상황 대비 추가적인 악화 가능성은 제한적일 것으로 판단된다.

포괄손익계산서

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
매출액	3,909	4,472	3,163	3,209	3,796
증가율(%)	20.2	14.4	-29.3	1.5	18.3
매출원가	2,602	2,944	2,293	2,319	2,559
매출원가율(%)	66.6	65.8	72.5	72.3	67.4
매출총이익	1,307	1,528	870	890	1,238
매출이익률(%)	33.4	34.2	27.5	27.7	32.6
판매관리비	525	600	561	578	584
판매관리비율(%)	13.4	13.4	17.7	18.0	15.4
EBITDA	890	1,025	388	374	720
EBITDA 이익률(%)	22.8	22.9	12.3	11.7	19.0
증가율(%)	72.1	15.2	-62.1	-3.6	92.6
영업이익	781	928	309	312	653
영업이익률(%)	20.0	20.8	9.8	9.7	17.2
증가율(%)	103.0	18.8	-66.7	0.8	109.4
영업외손익	144	73	312	333	147
금융수익	202	261	194	401	183
금융비용	45	199	115	81	48
기타영업외손익	-14	11	233	12	12
종속/관계기업관련손익	3	7	2	-1	-1
세전계속사업이익	928	1,008	623	644	800
증가율(%)	203.1	8.6	-50.1	27.3	17.1
법인세비용	204	235	138	213	157
계속사업이익	723	772	471	467	632
중단사업이익	0	0	-121	-4	-51
당기순이익	723	772	364	427	592
당기순이익률(%)	18.5	17.3	11.5	13.3	15.6
증가율(%)	235.7	6.8	-52.9	17.2	38.7
자배주주지분 순이익	719	765	366	428	594

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
영업활동으로인한현금흐름	16	927	316	554	748
당기순이익	723	772	364	427	592
유형자산 상각비	101	89	71	56	61
무형자산 상각비	8	8	7	6	5
외환손익	9	80	45	33	0
운전자본의감소(증가)	-945	-14	33	64	100
기타	120	-8	-204	-32	-10
투자활동으로인한현금흐름	-69	-58	256	-376	-56
투자자산의 감소(증가)	3	-42	288	265	-11
유형자산의 감소	9	21	3	1	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-52	-38	-50	-637	-50
기타	-29	1	15	-5	5
재무활동으로인한현금흐름	-32	-211	-157	-64	-60
차입금의 증가(감소)	4	-0	-34	0	0
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	-37	-110	-121	-54	-61
기타	1	-101	-2	-10	1
기타현금흐름	46	6	-7	107	0
현금의증가(감소)	-40	664	408	222	631
기초현금	968	928	1,592	2,001	2,222
기말현금	928	1,592	2,001	2,222	2,853

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
유동자산	3,707	4,237	4,293	4,456	5,072
현금성자산	928	1,592	2,001	2,222	2,854
단기투자자산	114	108	31	31	36
매출채권	1,061	809	818	989	926
재고자산	1,471	1,615	1,350	1,125	1,150
기타유동자산	133	113	94	89	106
비유동자산	1,953	1,921	1,823	2,074	2,068
유형자산	1,293	1,223	1,073	1,341	1,330
무형자산	52	46	51	48	42
투자자산	484	516	472	225	236
기타비유동자산	124	136	227	460	460
자산총계	5,660	6,159	6,117	6,530	7,140
유동부채	807	762	470	481	556
단기차입금	118	118	90	90	90
매입채무	330	225	157	150	181
기타유동부채	359	419	223	241	285
비유동부채	6	6	22	19	22
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	5	5	0	0	0
기타비유동부채	1	1	22	19	22
부채총계	813	768	492	500	579
자배주주지분	4,784	5,323	5,559	5,973	6,506
자본금	62	62	62	62	62
자본잉여금	760	760	760	758	758
자본조정 등	-56	-156	-156	-156	-156
기타포괄이익누계액	56	39	29	71	71
이익잉여금	3,962	4,618	4,864	5,238	5,772
자본총계	4,848	5,391	5,625	6,030	6,562

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025F
P/E(배)	20.5	10.7	51.4	40.0	30.5
P/B(배)	3.1	1.5	3.4	2.9	2.8
P/S(배)	3.8	1.8	6.0	5.3	4.8
EV/EBITDA(배)	15.6	6.5	43.7	40.2	21.4
배당수익률(%)	0.8	1.5	0.3	0.4	0.3
EPS(원)	5,835	6,212	2,973	3,478	4,824
BPS(원)	38,830	43,208	45,119	48,481	52,814
SPS(원)	31,727	36,297	25,678	26,052	30,816
DPS(원)	900	1,000	450	500	500
수익성(%)					
ROE	16.3	15.1	6.7	7.4	9.5
ROA	13.8	13.1	5.9	6.7	8.7
ROIC	20.9	21.5	6.5	10.6	16.4
안정성(%)					
유동비율	459.6	556.2	913.1	926.4	911.5
부채비율	16.8	14.2	8.8	8.3	8.8
순차입금비율	-18.9	-29.2	-34.5	-35.9	-42.7
이자보상배율	471.4	281.5	89.0	113.4	237.6
활동성(%)					
총자산회전율	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6
매출채권회전율	4.6	4.8	3.9	3.6	4.0
재고자산회전율	3.1	2.9	2.1	2.6	3.3

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공 정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다. ※관련근거 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
이오테크닉스	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2025.06.12	이오테크닉스-반도체향 매출 비중 증가는 현재형

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양 질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/kirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.